

MSKSEMI 美森科

SEMICONDUCTOR



ESD



TVS



TSS



MOV



GDT



PLED

MSTP4054-42

Product specification

概述

MSTP4054-42 是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器，简单的外部应用电路非常适合便携式设备应用，适合 USB 电源和适配器电源工作，内部采用防倒充电路，不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节，以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。

MSTP4054-42 满充电压为 4.2V，充电电流可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至充电终止电流 EOC 时，MSTP4054-42 将自动结束充电过程。

当输入充电器被移掉后，MSTP4054-42 自动进入低电流待机状态，待机电流降至 5nA。

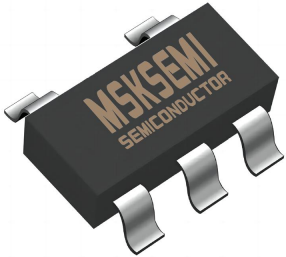
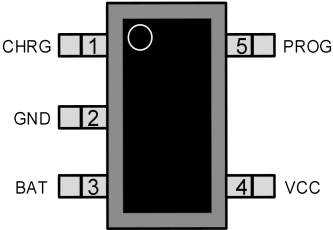
特性

- 最大充电电流：500mA
- 超低功耗：5nA
- 无需 MOSFET、检测电阻器和隔离二极管
- 智能热调节功能可实现充电速率最大化
- 智能再充电功能
- 预充电压：4.2V
- 充电终止电流：75mA
- 涓流充电阈值：2.9V
- 封装形式：SOT23-5L
- ESD HBM：2KV

应用

- 充电座
- 蓝牙耳机、GPS
- 手机、PDA、MP3/MP4
- 数码相机、Mini 音响等便携式设备

引脚描述和标记

SOT-23-5	引脚排列	管体标记
		

引脚定义

管脚	符号	描述
1	CHRG	充电状态指示端
2	GND	电源地
3	BAT	电池正端
4	VCC	充电器正端
5	PROG	充电电流设置端

引脚功能描述

CHRG(PIN1): 充电状态指示端

当充电器向电池充电时，CHRG引脚被内部开关拉到低电平，表示充电正在进行；当充电结束时，CHRG管脚处于高阻态，插入充电器而没接电池的话指示灯会闪烁提示未接电池或电池接触不好。

GND(PIN2): 电源地

BAT(PIN3): 电池正端

将电池的正端连接到此管脚。无VCC接入或者电池充满进入待机状态后，BAT管脚的漏电流5nA，BAT管脚向电池提供充电电流和4.2V的充满电压。

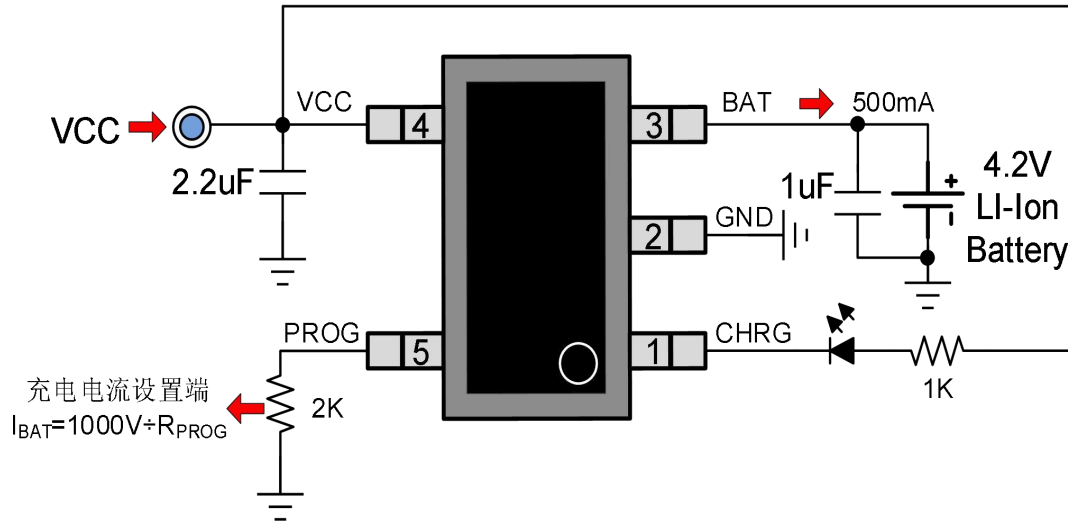
VCC(PIN4): 充电器正端

此管脚的电压为内部电路的工作电源。VCC输入电压必须大于欠压锁定阈值且同时大于BAT电压100mV时，充电才会开始。当VCC输入电压低于欠压锁定阈值或VCC与BAT管脚的电压差小于50mV时，LTH7(MS)将进入低功耗的停机模式，此时BAT管脚的消耗电流5nA。

PROG(PIN5): 充电电流设置端

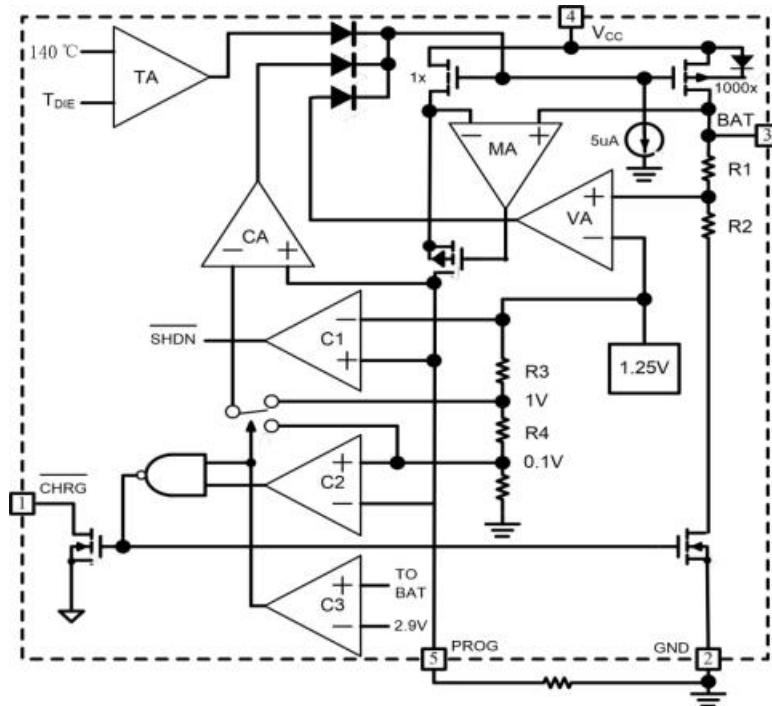
从PROG管脚连接一个电阻到GND可以对充电电流进行设定。设定电阻器和充电电流采用下列公式来计算： $I_{BAT}=1000V \div R_{PROG}$ ，根据需要的充电电流 I_{BAT} 来确定电阻器 R_{PROG} 的阻值。在涪流充电阶段，此管脚的电压被调制在0.1V；在恒流充电阶段，此管脚的电压被固定在1V。

典型应用电路图



注 1: 充电电流设置电阻最小不能小于2KΩ。

内部框架图



极限参数

符号	参数	额定值	单位
VCC	输入电源电压	-0.3~9	V
PROG	PROG脚电压	-0.3~9	V
BAT	BAT脚电压	-9~9	V
CHRG	CHRG脚电压	-0.3~9	V
IBAT	BAT脚电流	500	mA
I PROG	PROG脚电流	600	uA
TOP	工作环境温度	-20~85	°C
TSTG	储存温度	-65~125	°C
ESD	HBM	2000	V
LATCH UP	栓锁试验	±200	mA

注2：最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。

电气参数

无特殊说明，VCC=5V，Temp=25°C

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VCC	输入电源电压		4.5	5	6.5	V
VFLOAT	输出浮充电压	$0^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq 85^{\circ}\text{C}$		4.2		V
ICC	恒流充电电流	RPROG=2K，电流模式		500		mA
ITRIKL	涓流充电电流	$V_{BAT} < V_{TRIKL}$, RPROG=2K	35	50	65	mA
IBAT	BAT电流	待机模(VCC=5V,VBAT=4.3V)		1.2		μA
		睡眠模式, (VCC=0V,VBAT=4.2V)		5	100	nA
VTRIKL	涓流充电阈值电压	RPROG=2K, VBAT上升	2.8	2.9	3.0	V
VTRHYS	涓流充电迟滞电压	RPROG=2K	140	180	220	mV
VUV	VCC欠压保护阈值电压	VCC下降	3.3	3.5	3.7	V
VUVHYS	VCC欠压保护迟滞电压	VCC上升		0.2		V
VASD	VCC-VBAT阈值电压	VCC上升		110		mV
		VCC下降		50		mV
VPROG	PROG引脚电压	RPROG=2K，电流模式	0.9	1.0	1.1	V
VCHRG	CHRG引脚输出低电压	ICHRG=5mA		50		mV
ΔVRECHRG	再充电电池阈值电压	VFLOAT-VRECHRG		120		mV
TLIM	限定温度模式结温			140		°C
TRECHRG	再充电比较器滤波时间	VBAT下降		1.2		mS
TTERM	结束比较器滤波时间	IBAT降至EOC以下		1.4		mS

注4：典型参数值为25°C条件下测得的标准参数值。

芯片功能描述

MSTP4054-42 是专门为一节锂离子电池或锂聚合物电池而设计的线性充电器，芯片集成功率晶体管，充电电流可以用外部电阻设定，最大持续充电电流可达**500mA**，不需要另加阻流二极管和电流检测电阻。

MSTP4054-42 包含一个漏极开路输出的状态指示端，用于指示正在充电或充电完成。充电时管脚**CHRG**输出低电平，表示充电正在进行，充电完成后**CHRG**脚变为高阻态。

如果电池电压低于**2.9V**，MSTP4054-42 用小电流对电池进行预充电。当电池电压超过**2.9V**时，采用恒流模式对电池充电，充电电流由**PROG**管脚和**GND**之间的电阻**RPROG**确定。当电池电压接近**4.2V**电压时，充电电流逐渐减小，MSTP4054-42 进入恒压充电模式。当充电电流减小到充电结束阈值**EOC**时，充电周期结束。充电结束阈值是恒流充电电流的**15%**。

当电池电压降到再充电阈值**4.08V**以下时，MSTP4054-42 自动开始新的充电周期。芯片内部的高精度电压基准源误差放大器和电阻分压网络确保电池端调制电压的精度在**1%**以内，满足锂离子电池和锂聚合物电池的要求。当输入电压低于欠压锁定阈值电压或者输入电压低于电池电压时，充电器进入低功耗的睡眠模式，此时电池端消耗的电流**5nA**。

MSTP4054-42 内部的智能温度控制电路在芯片的结温超过**140℃**时自动降低充电电流，这个功能可以使用户最大限度的利用芯片的功率处理能力，不用担心因为过热而损坏芯片或者外部元器件。这样，用户在设计充电电流时，可以不用考虑最坏情况，而只是根据典型情况进行设计因为在最坏情况下，MSTP4054-42 会自动减小充电电流。

应用说明

充电终止

当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的15%时，充电过程结束。该条件是通过采用一个内部滤波比较器对PROG引脚进行监控来检测的，当PROG引脚电压降至100mV以下的时间超过1.4mS时，充电终止。

智能再充电

在待机模式中，MSTP4054-42 对BAT引脚电压进行监控，只有当BAT引脚电压低于再充电阈值电压4.08V时(对应电池容量80%~90%)，才会开始新的充电循环，重新对电池进行充电，这就避免了对电池进行不必要的反复充电,有效延长电池的使用寿命。

增加热调节电阻

降低IC的VCC与BAT两端的压降能够显著减少IC中的功耗。在热调节时，这具有增加充电电流的作用。实现方式可以在输入电源与VCC之间串联一个0.5欧姆的电阻或正向导通压降小于0.5V的二极管，从而将一部分功率消耗掉。

充电电流软启动

MSTP4054-42 内置了软启动路。当一个充电循环被启动时，充电电流将在20uS的时间从零逐渐上升至恒流充电电流。

充电状态指示灯

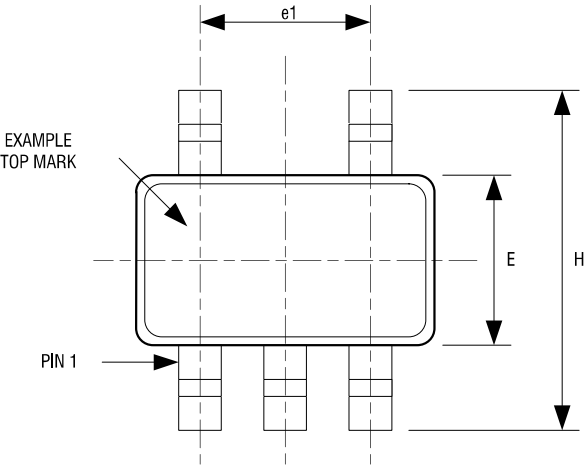
CHRG为漏极开路状态指示输出端,当充电器处于充电状态时，CHRG被下拉为低电平，充电结束后，CHRG管脚处于高阻态；如果不接电池，插入充电器时BAT脚电压为4.3V左右；如果不使用状态指示功能时，将CHRG浮空或接地。

智能温度控制

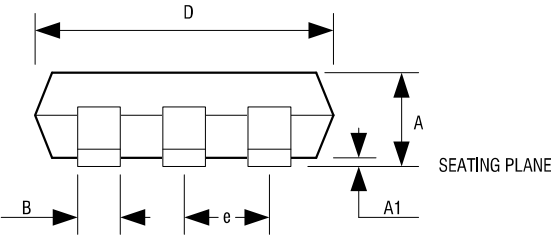
MSTP4054-42 内部集成了智能温度控制功能，当芯片温度高于140℃时,会自动减小充电电流。该功能允许用户提高给定电路板功率处理能力的上限而没有损坏 MSTP4054-42 的风险。在保证充电器将在最坏情况条件下自动减小电流的前提下，可根据典型（而不是最坏情况）环境温度来设定充电电流。

封装外形尺寸(SOT23-5)

SOT23-5



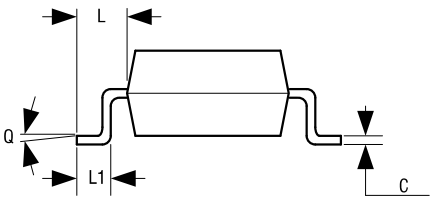
TOP VIEW



FRONT VIEW

5LD SOT-23 PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS

Dimension	Min.	Max.
A	1.05	1.35
A1	0.04	0.15
B	0.3	0.5
C	0.09	0.2
D	2.8	3.0
H	2.5	3.1
E	1.5	1.7
e	0.95 REF.	
e1	1.90 REF.	
L1	0.2	0.55
L	0.35	0.8
Q	0°	10°



SIDE VIEW

- NOTE:
1.DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
2.DRAWING NOT TO SCALE
3.DIMENSIONS ARE INCLUSIVE OF PLATING
4.DIMENSIONS ARE EXCLUSIVE OF MOLD FLASH AND METAL BURR

订货信息

料号	封装	包装
MSTP4054-42	SOT-23-5	3000PCS

Attention

■ Any and all MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein do not have specifications that can handle applications that require extremely high levels of reliability, such as life-support systems, aircraft's control systems, or other applications whose failure can be reasonably expected to result in serious physical and/or material damage. Consult with your MSKSEMI Semiconductor representative nearest you before using any MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein in such applications.

■ MSKSEMI Semiconductor assumes no responsibility for equipment failures that result from using products at values that exceed, even momentarily, rated values (such as maximum ratings, operating condition ranges, or other parameters) listed in products specification of any and all MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein.

■ Specifications of any and all MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein stipulate the performance, characteristics, and functions of the described products in the independent state, and are not guarantees of the performance, characteristics, and functions of the described products as mounted in the customer's products or equipment. To verify symptoms and states that cannot be evaluated in an independent device, the customer should always evaluate and test devices mounted in the customer's products or equipment.

■ MSKSEMI Semiconductor strives to supply high-quality high-reliability products. However, any and all semiconductor products fail with some probability. It is possible that these probabilistic failures could give rise to accidents or events that could endanger human lives, that could give rise to smoke or fire, or that could cause damage to other property. When designing equipment, adopt safety measures so that these kinds of accidents or events cannot occur. Such measures include but are not limited to protective circuits and error prevention circuits for safe design, redundant design, and structural design.

■ In the event that any or all MSKSEMI Semiconductor products (including technical data, services) described or contained herein are controlled under any of applicable local export control laws and regulations, such products must not be exported without obtaining the export license from the authorities concerned in accordance with the above law.

■ No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or any information storage or retrieval system, or otherwise, without the prior written permission of MSKSEMI Semiconductor.

■ Information (including circuit diagrams and circuit parameters) herein is for example only ; it is not guaranteed for volume production. MSKSEMI Semiconductor believes information herein is accurate and reliable, but no guarantees are made or implied regarding its use or any infringement of intellectual property rights or other rights of third parties.

■ Any and all information described or contained herein are subject to change without notice due to product/technology improvement, etc. When designing equipment, refer to the "Delivery Specification" for the MSKSEMI Semiconductor product that you intend to use.